

2013年3月期第2四半期 決算説明会

荏原 (6361)

2012年11月5日



目次

1. 決算概要

取締役専務執行役員
連結経営・経理財務担当

藤本 哲司

2. 方針と施策

代表取締役社長

矢後 夏之助

1. 決算概要

取締役専務執行役員
連結経営・経理財務担当

藤本 哲司

(単位：億円)

	2012年3月期 第2四半期 (実績)	2013年3月期 第2四半期 (実績)	増減
受注高	1,856	1,882	+25
売上高	1,759	1,636	△122
営業利益	30	11	△18
経常利益	1	5	+3
四半期純利益	△3	△10	△7

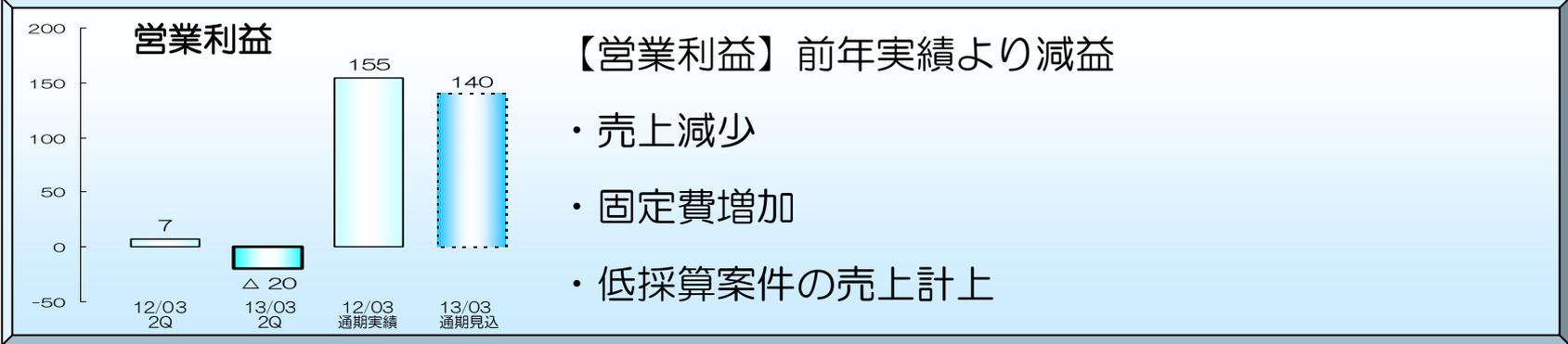
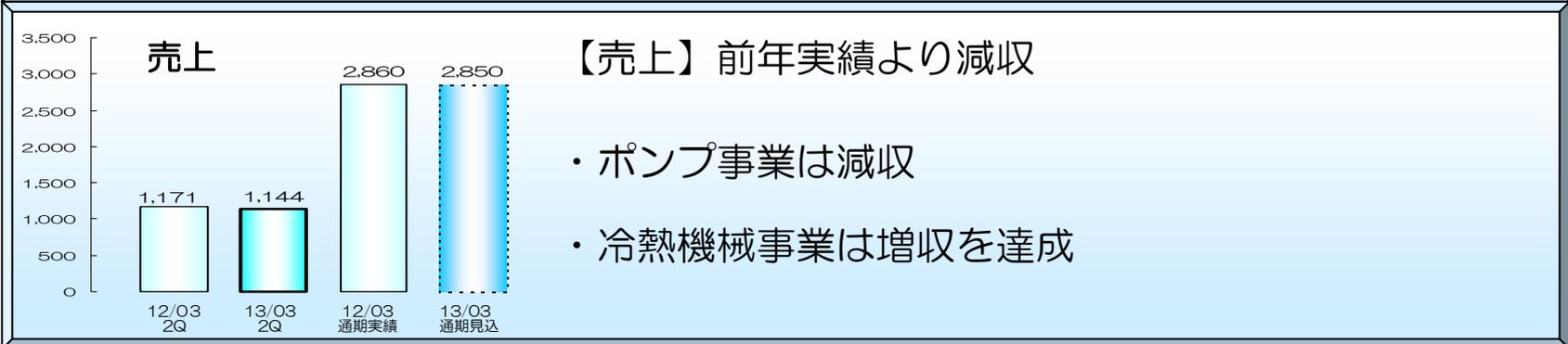
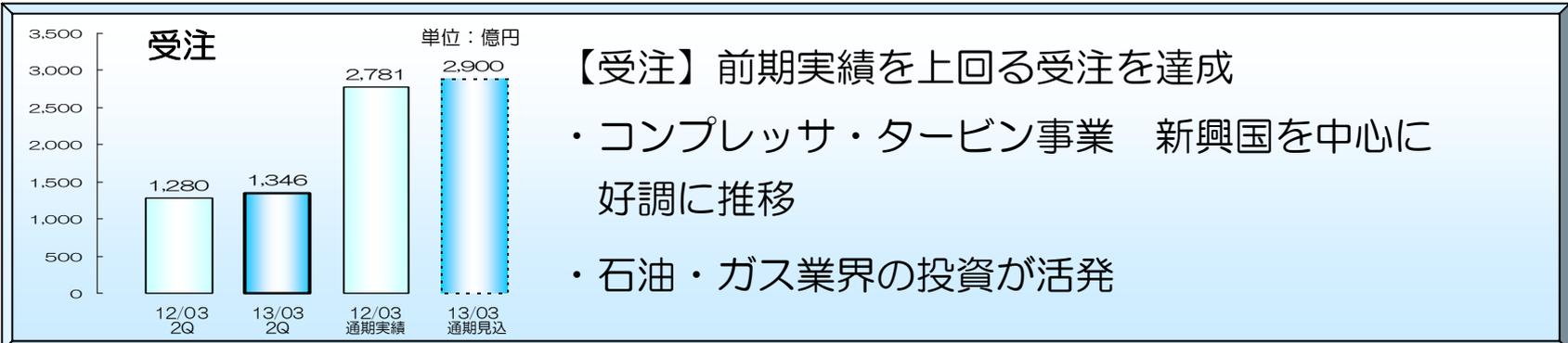
実績レート	1ドル=80.4円	1ドル=79.7円	—
想定レート	1ドル=80円	1ドル=75円	—

※ 本資料において、特に記載のない限り「第2四半期」「2Q」は4月1日～9月30日の6ヶ月累計期間とします。

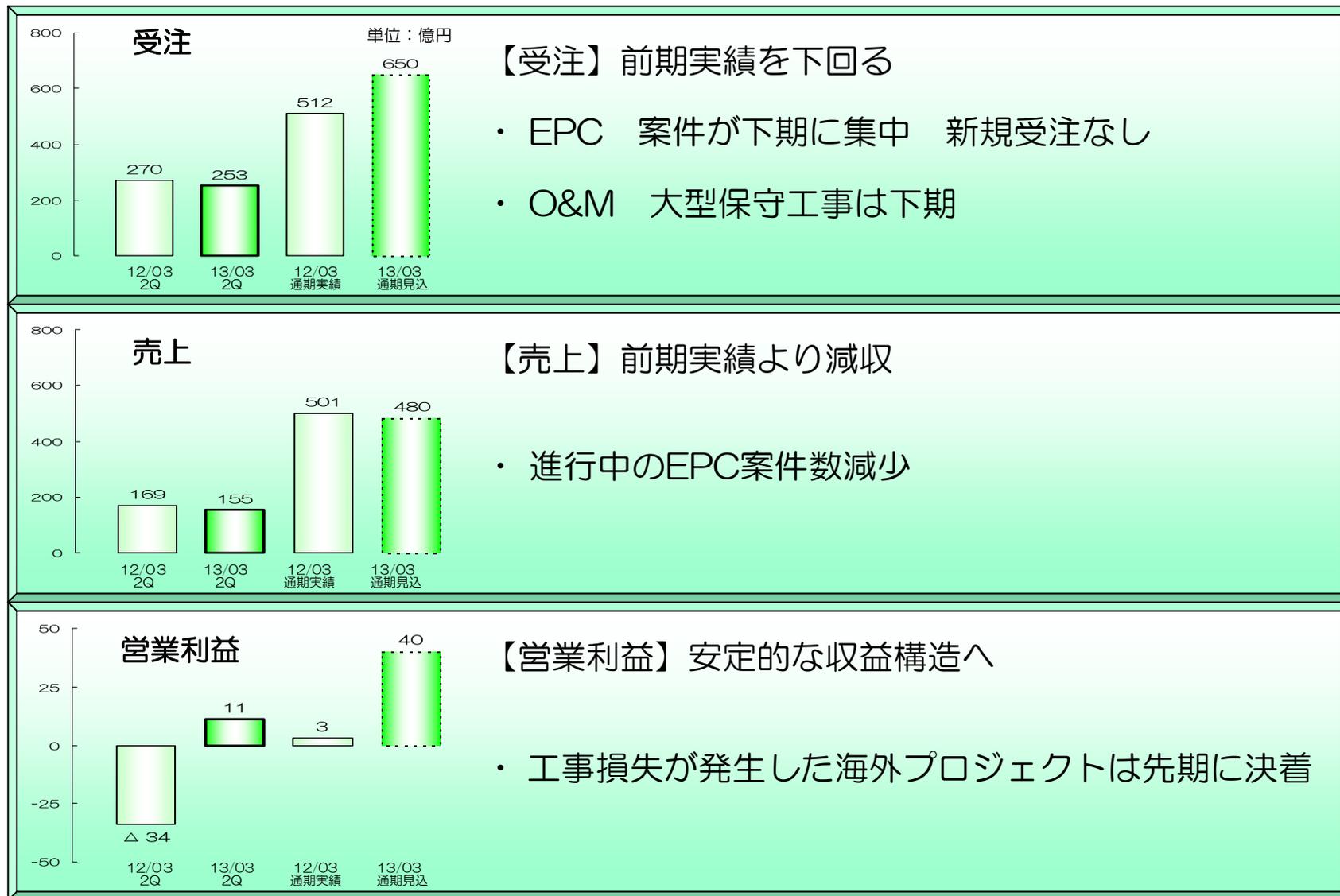
(単位：億円)

		受注高			売上高			営業利益		
		2012年 3月期 2Q	2013年 3月期 2Q	増減	2012年 3月期 2Q	2013年 3月期 2Q	増減	2012年 3月期 2Q	2013年 3月期 2Q	増減
報告セグメント	風水力事業	1,280	1,346	+65	1,171	1,144	△26	7	△20	△27
	エンジニアリング事業	270	253	△16	169	155	△14	△34	11	+46
	精密・電子事業	283	282	△1	373	327	△45	53	16	△37
	その他の事業	22	0	△21	45	8	△36	2	3	+0
調整額		—	—	—	—	—	—	1	0	△0
合計		1,856	1,882	+25	1,759	1,636	△122	30	11	△18

風水力事業



エンジニアリング事業

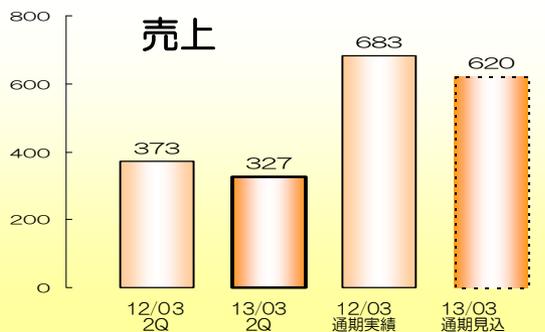


精密・電子事業



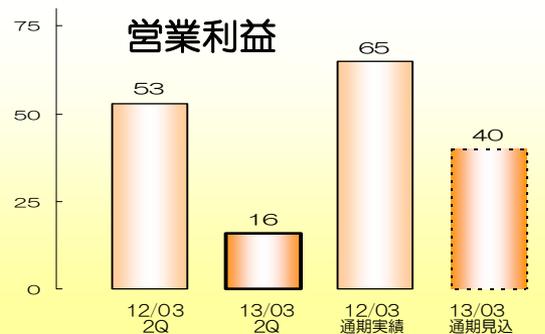
【受注】 前期実績とほぼ変わらず

- ・ 世界的な景況感の悪化で、半導体需要は依然低迷
- ・ 半導体メーカーの設備投資計画が相次いで延期に



【売上】 前期実績を大きく下回る

- ・ 低調な受注により売上也落ち込む
- ・ 一部の客先の微細化投資は堅調



【営業利益】 前期実績比で大幅減少

- ・ 売上減少
- ・ 生産革新活動が進捗するも、生産量が低調で効果薄

1. 決算概要

2013年3月期 業績見通し

(1/2)

(単位：億円)

	2012年3月期 (実績) (A)	2013年3月期 (期初計画) (B)	2013年3月期 (見込み) (C)	増減 (対計画比) (C-B)	増減 (対前期比) (C-A)
受注高	3,949	4,220	4,170	△50	+220
売上高	4,120	4,000	3,970	△30	△150
営業利益	232	270	225	△45	△7
経常利益	210	250	215	△35	+4
当期純利益	28	130	105	△25	+76

実績レート	1ドル=85.9円	—	—	—	—
想定レート	(上期)1ドル=80円 (下期)1ドル=75円	1ドル=75円	1ドル=75円	—	—

1. 決算概要

2013年3月期 業績見通し セグメント別

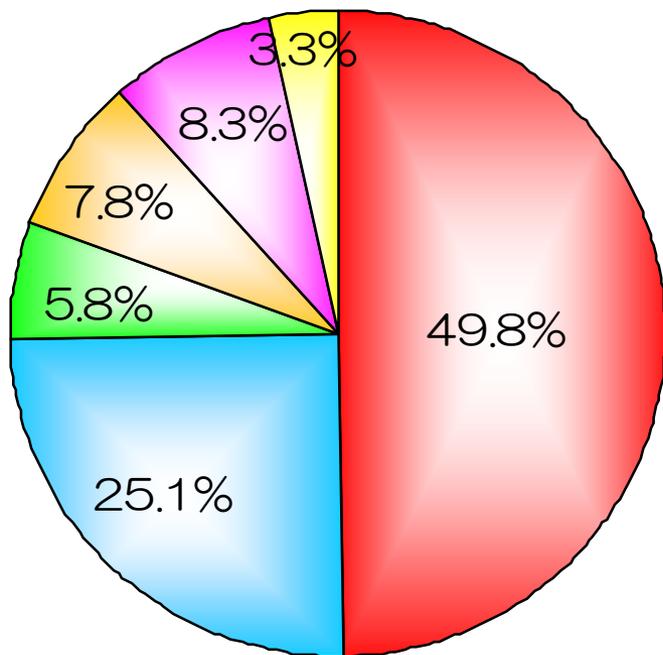
(2/2)

(単位：億円)

		2012年3月期 (実績) (A)	2013年3月期 (期初計画) (B)	2013年3月期 (見込み) (C)	増減 (対計画比) (C-B)	増減 (対前期比) (C-A)
風水力	受注	2,781	2,900	2,900	—	+118
	売上	2,860	2,850	2,850	—	△10
	営業利益	155	160	140	△20	△15
エンジニア リング	受注	512	650	650	—	+137
	売上	501	480	480	—	△21
	営業利益	3	40	40	—	+36
精密・電子	受注	617	650	600	△50	△17
	売上	683	650	620	△30	△63
	営業利益	65	65	40	△25	△25
その他、 調整	受注	37	20	20	—	△17
	売上	74	20	20	—	△54
	営業利益	7	5	5	—	△2
合計	受注	3,949	4,220	4,170	△50	+220
	売上	4,120	4,000	3,970	△30	△150
	営業利益	232	270	225	△45	△7

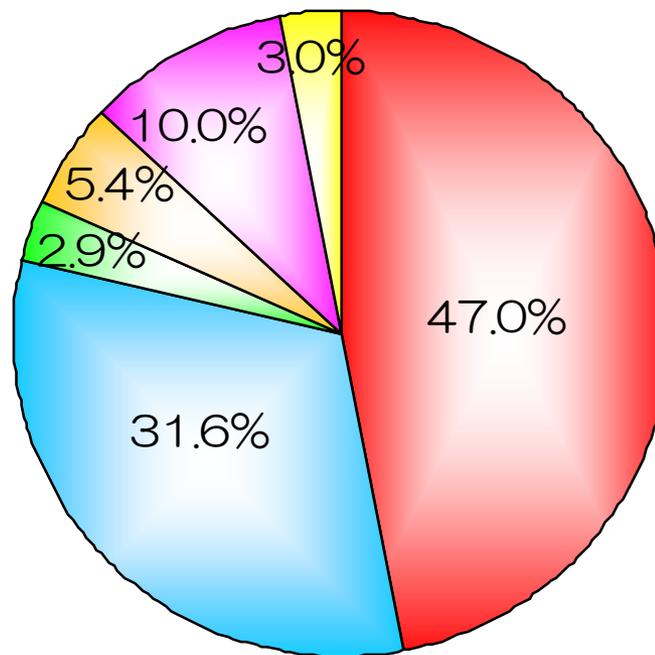
地域別売上構成

12年3月期
第2四半期 売上 1,759億円



海外売上比率
50.2%

13年3月期
第2四半期 売上 1,636億円



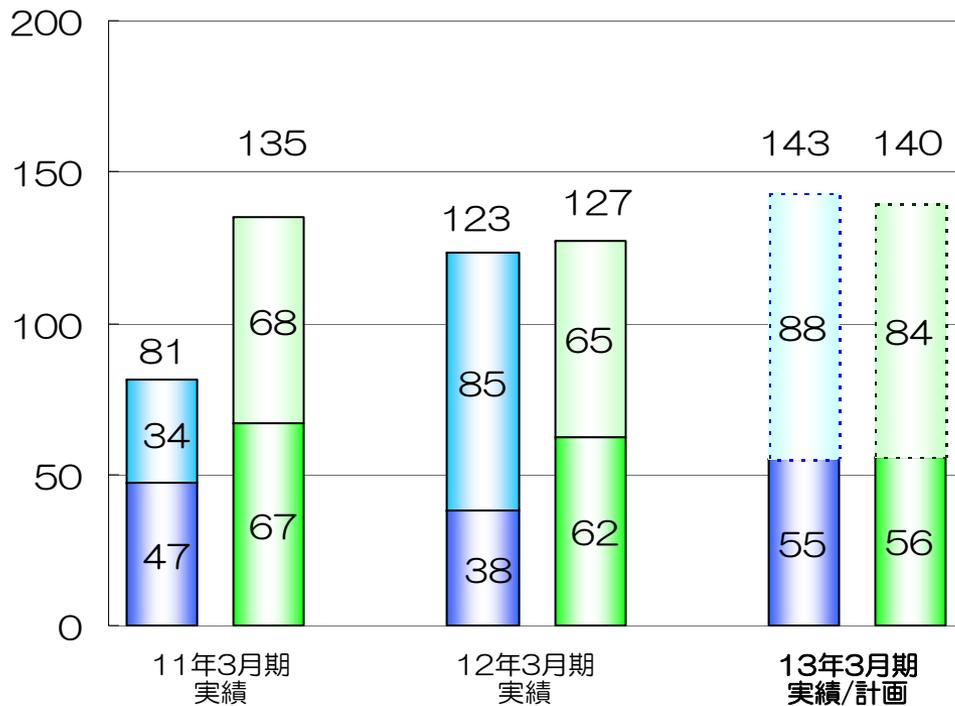
海外売上比率
53.0%



資本的支出・減価償却費

- 資本的支出（上期）
- 資本的支出（下期）
- 減価償却費（上期）
- 減価償却費（下期）

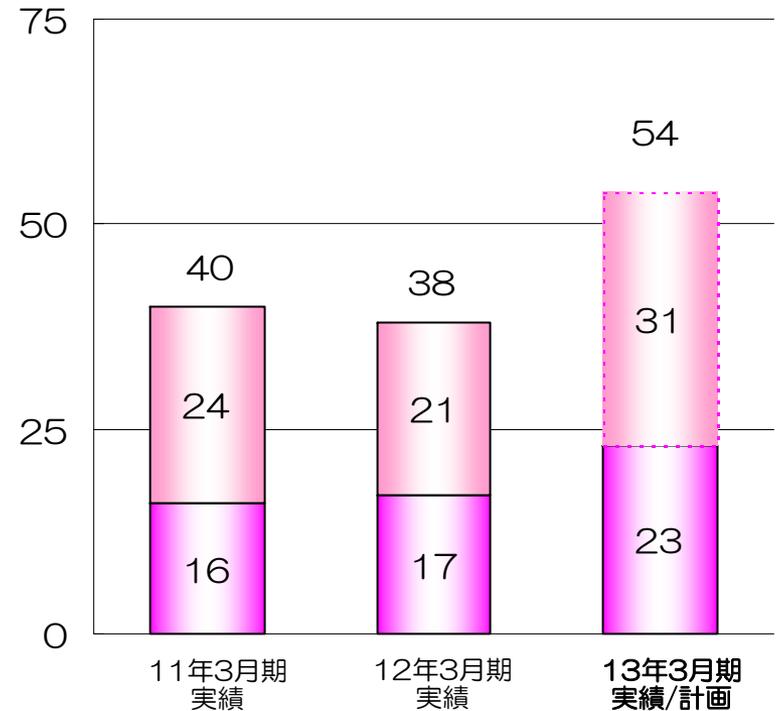
(単位：億円)



研究開発費

- 研究開発費（上期）
- 研究開発費（下期）

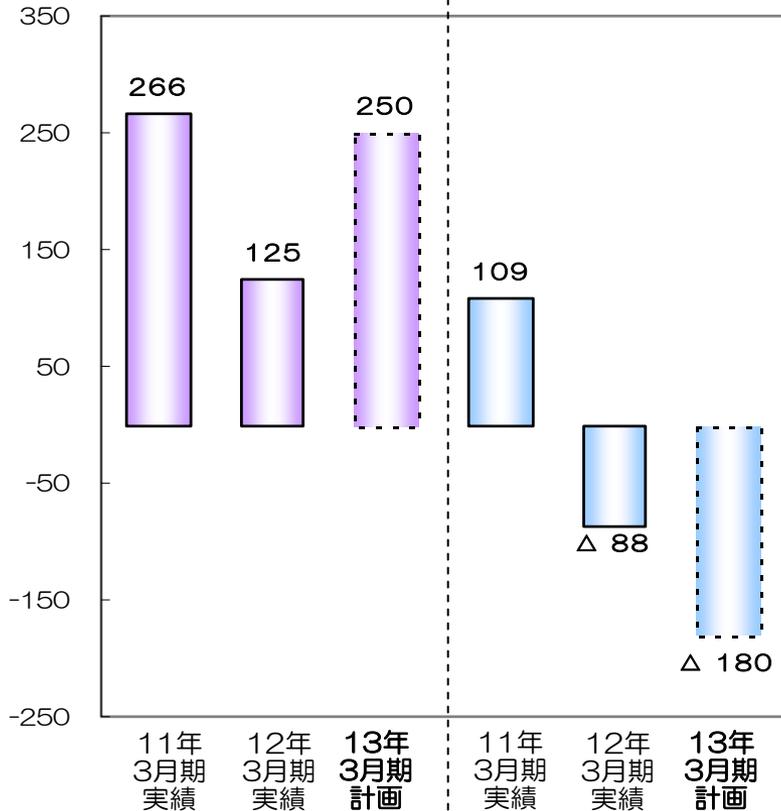
(単位：億円)



キャッシュフロー計画

- 営業活動キャッシュフロー
- 投資活動キャッシュフロー

(単位：億円)

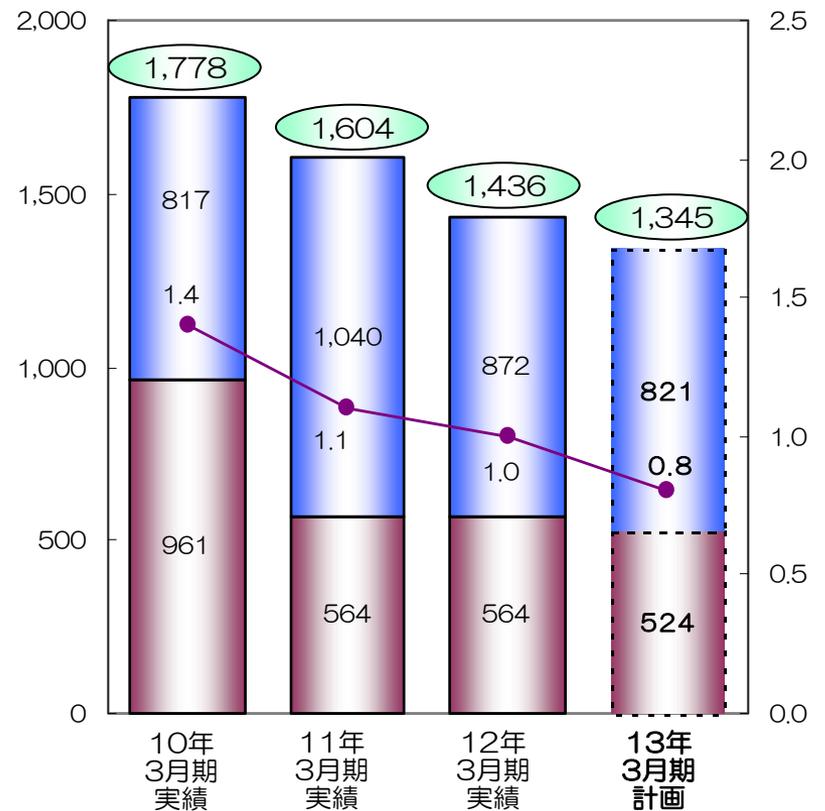


有利子負債計画

- 有利子負債
- 現預金及び現金同等物
- NET有利子負債
- D/Eレシオ

(単位：億円)

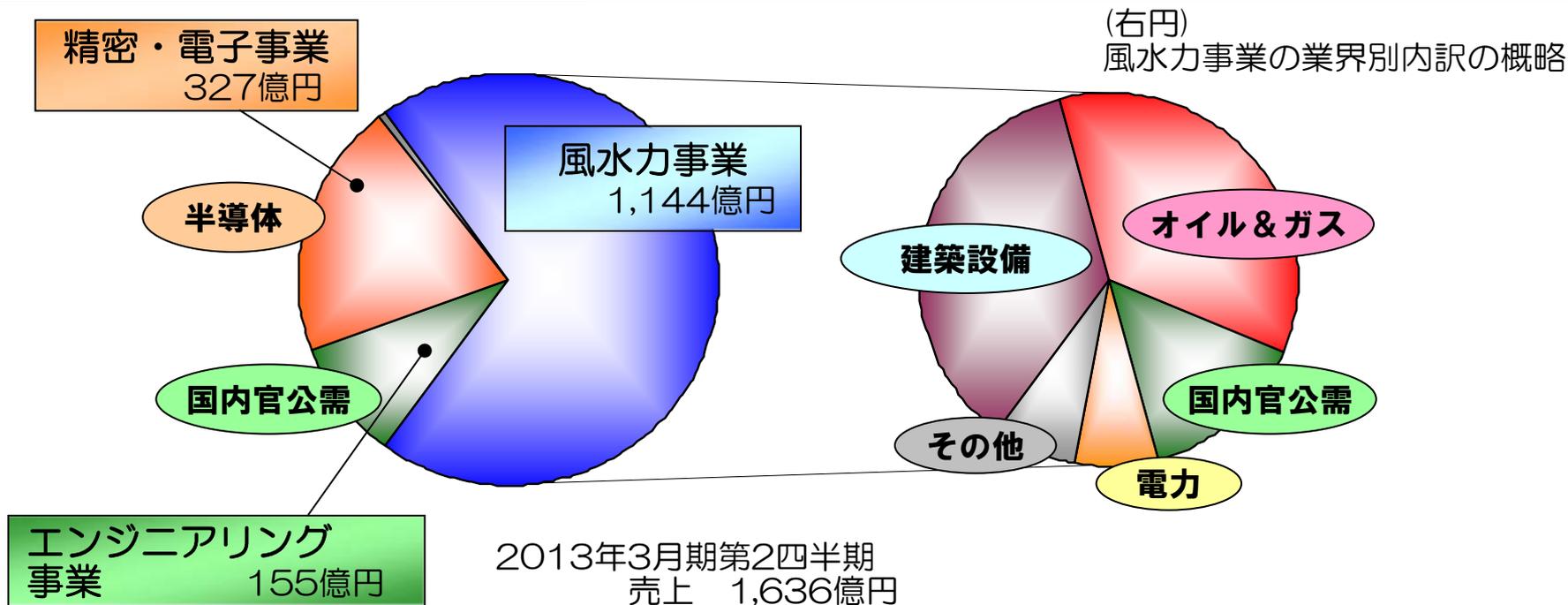
(単位：倍)



2. 方針と施策

代表取締役社長

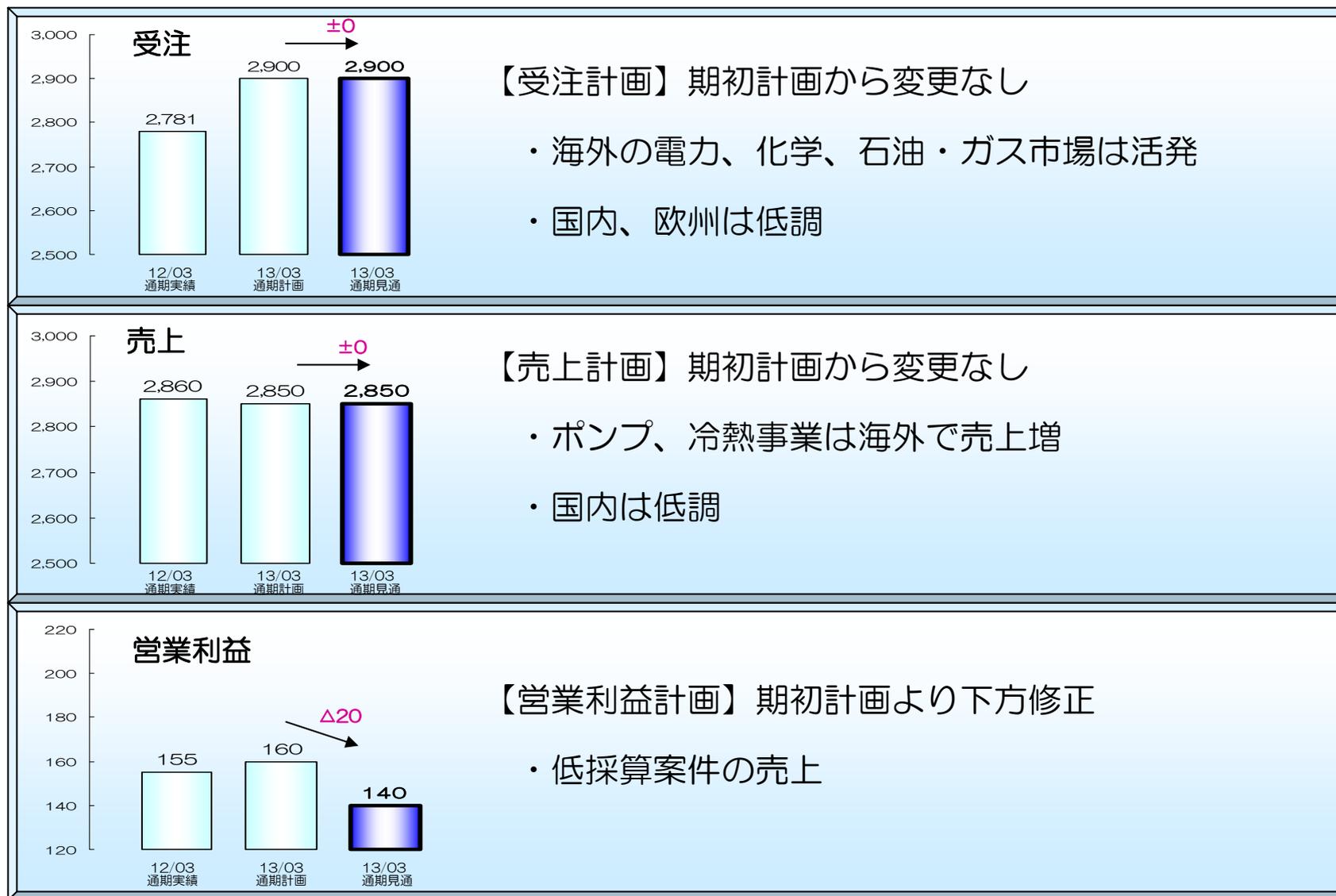
矢後 夏之助



主な事業環境

- オイル&ガス
 → エネルギー需要の高まりにより受注好調
- 国内官公需
 → 先期は震災後の予算執行遅れ等により不調、今期は平常化
- 建築設備
 → 国内中心、安定的
- 半導体
 → 期中に市場環境が悪化、設備投資計画が延期に

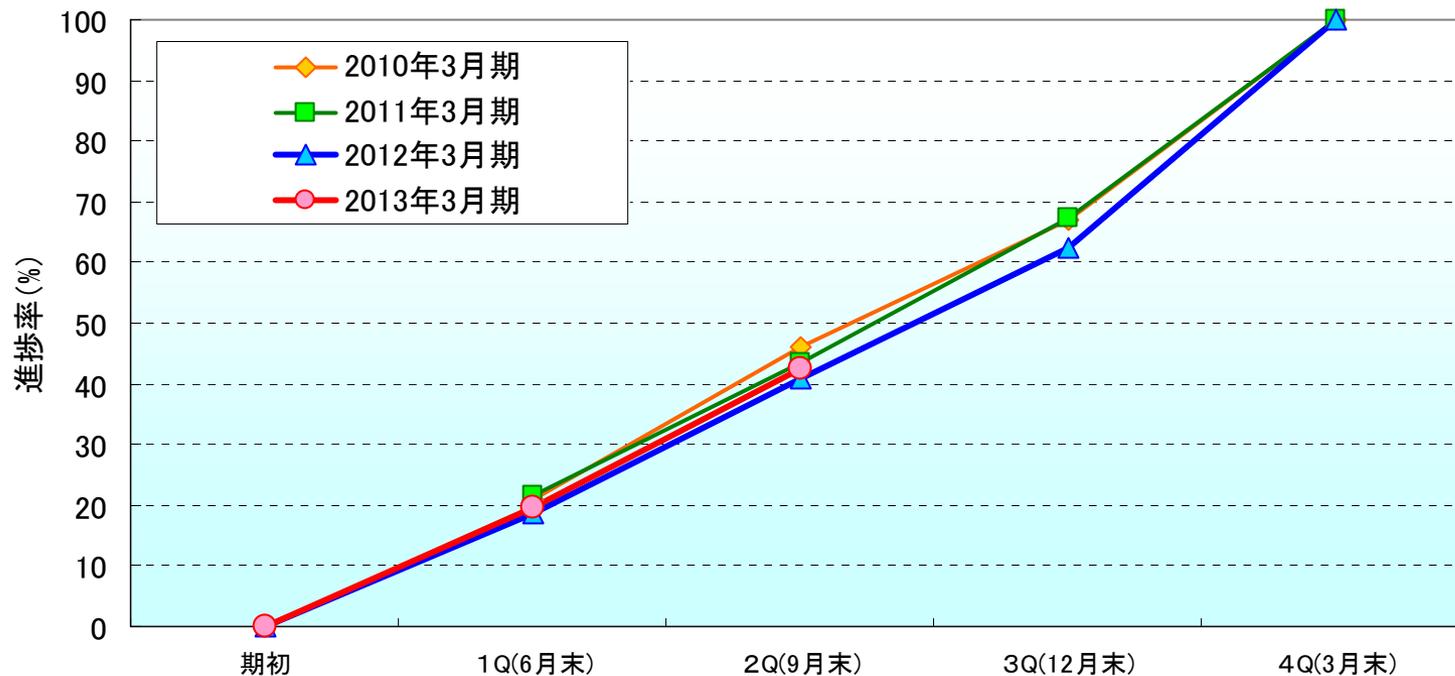
風水力事業



今期第2四半期の売上は 対修正計画の約4割の進捗

- 売上の上／下期のバランスは数年来変わらず
- 今期も売上は下期に偏重、売上に合わせて利益も下期偏重となる見込み

(表)風水力事業の売上の通期実績に対する四半期進捗

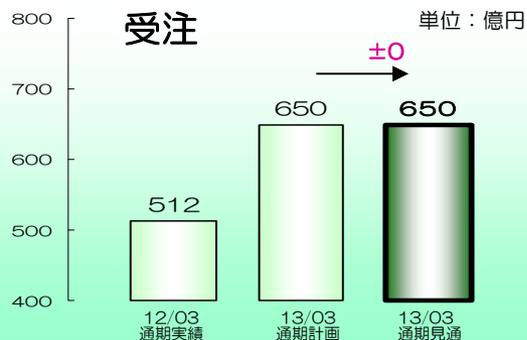


(※)2013年3月期は2Q実績まで

風水力事業

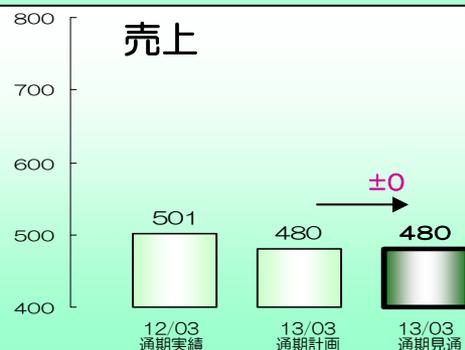
事業方針	主要施策
<p>現地化推進によるグローバル事業拡大</p>	<p>ポンプ事業</p> <p>海外</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中国、東南アジア、中東の地域統括体制による事業強化 →各地域施策を推進 ・グループネットワークを活用した受注体制の構築 →拠点間連携の推進 ・提案メニューの拡大によるサービス&サポートの拡充 →ローカル拠点の機能強化 <p>国内</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経営資源の再配分・カスタマーサービス工場によるサービス&サポート事業の強化 ・顧客ニーズに合致した製品の市場投入 →顧客ニーズの取込推進 <p>技術生産</p> <ul style="list-style-type: none"> ・迅速な製品開発及び価格・納期面での製品競争力強化 →製品開発への顧客ニーズ吸上 ・国内の生産革新活動の進展及び海外拠点への展開 →中国より展開開始
<p>生産革新の展開</p>	<p>（上記の国内・技術生産施策に該当）</p>
<p>成長分野への注力</p>	<p>コンプレッサ・タービン事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・グローバルに展開する販売・サービス拠点の拡充 →アジアを皮切りに継続的に整備 ・エネルギー分野向け製品ラインアップの拡充 ・北米でのシェールガス関連プロジェクトへの積極的対応 →石化案件取り込み
<p>サービス&サポート事業の強化</p>	<p>冷熱事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・急拡大するヒートポンプ市場及び堅調な冷凍機市場に向けた中国拠点の拡大 ・国内のサービス事業の拡充、東南アジアの販売サービスの拡大 →東南アジア拠点設置へ

エンジニアリング事業



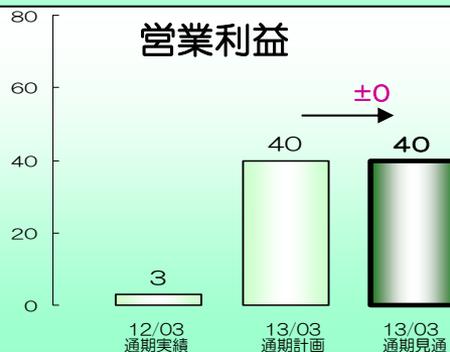
【受注計画】 期初計画は達成の見込み

- ・ EPC 新設案件の受注を目指す
- ・ O&M 基幹的設備改良工事など堅調に推移



【売上計画】 期初計画は達成の見込み

- ・ 前期実績比ではEPCの売上が減少の見込み



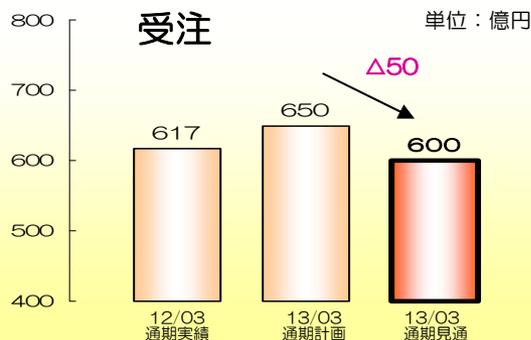
【営業利益計画】 期初計画の達成を見込む

- ・ O&M 収益力強化

エンジニアリング事業

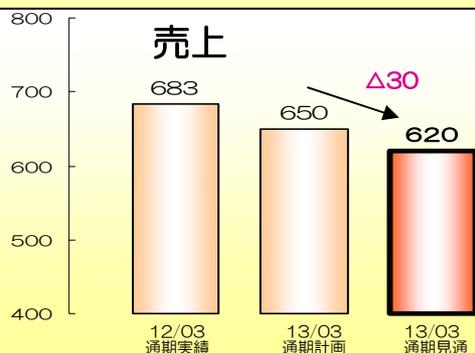
事業方針	主要施策
安定した 経営基盤の確立	<p>O&M事業の収益力強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ EPCの設計ノウハウを活用した既設炉の基幹改良工事の受注 ・ 複数年／長期包括維持管理契約の推進と採算性向上
事業ストックの 安定的確保	<p>建替需要の受注</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国サービス網を活用した建替案件の早期把握 ・ EPCのノウハウとO&Mのノウハウを融合したDBOおよびEPC案件提案
製品競争力の 強化	<p>焼却炉技術センターによる技術標準化と開発の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門組織による標準化・パッケージ化の一層の推進 ・ 省エネルギー化技術および高効率発電技術の確立

精密・電子事業



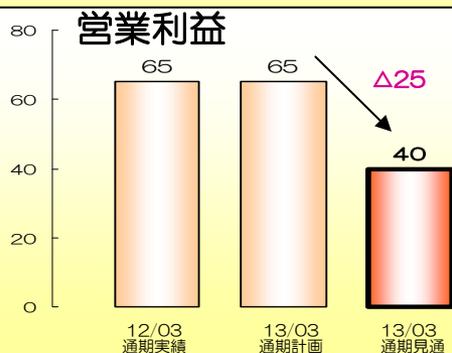
【受注計画】 期初計画を下方修正

- ・ 主要顧客の多くが設備投資計画の延期を発表
- ・ 一部の顧客は堅調に投資を継続



【売上計画】 期初計画を下方修正

- ・ 受注減少の影響により期初計画を下回る見込み



【営業利益計画】 期初計画を下方修正

- ・ 売上減少の影響により期初計画を下回る見込み
- ・ 生産量低下により生産革新活動の効果も限定的
- ・ 微細化などの開発は継続

精密・電子事業

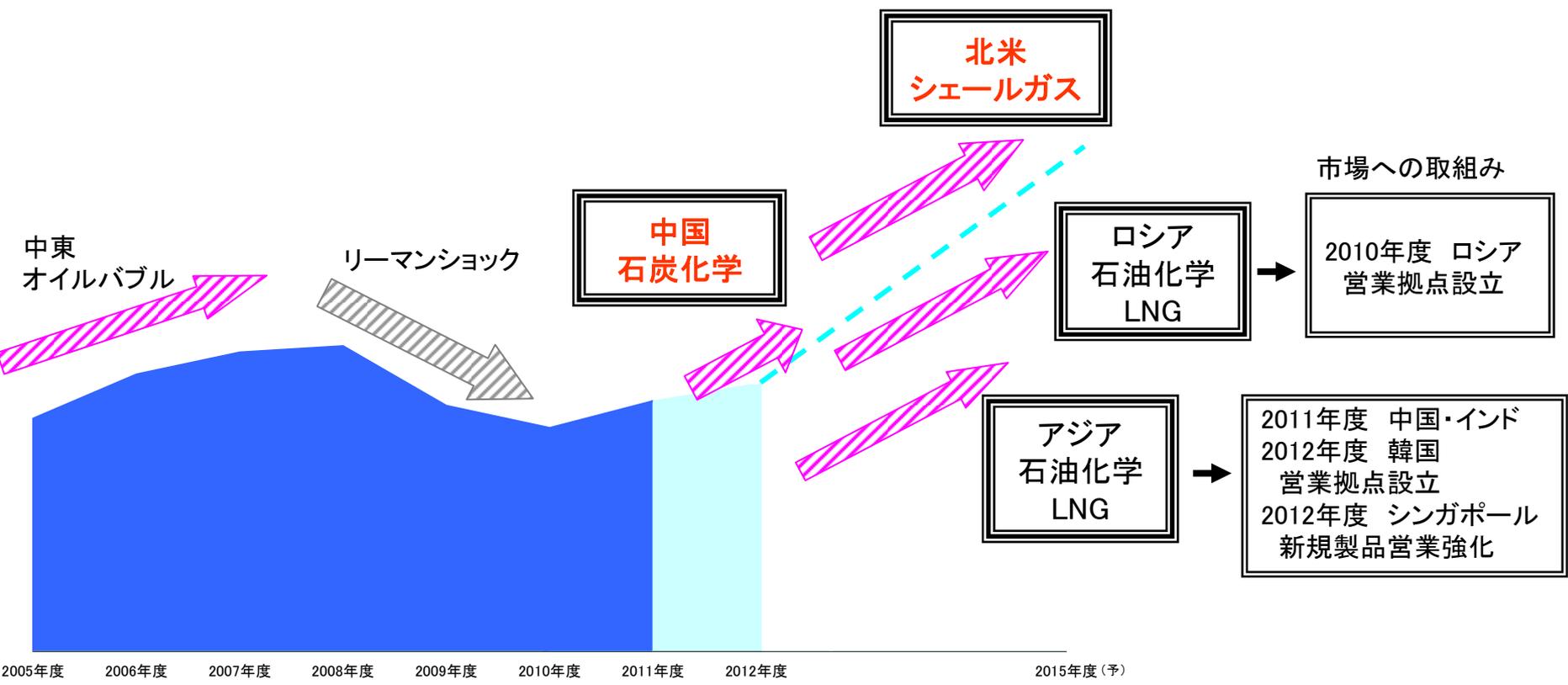
事業方針	主要施策
市況に左右されない 事業体質の構築	<p>コンポーネント機器事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・半導体・非半導体向け機器の更なるシェア拡大 ・一般真空産業向け製品の市場参入
高収益の確保	<p>CMP装置事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主力機種300SⅡの成熟と継続的なコストダウン ・微細化、大口径化、三次元集積化に対応した装置の開発
高収益の確保	<p>新事業推進（めっき装置、ベベル研磨装置、その他）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三次元集積化実現に向けた製品の市場投入 ・ベベル研磨装置のウェーハ内収率改善技術への応用
人材配置の最適化	<p>ものづくりプロセス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生産革新活動の定着・浸透による生産性向上 ・海外生産比率・海外調達比率の上昇
	<p>サービス&サポート事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな対応を通じたサービス&サポート事業の強化 ・グローバルな在庫の一元管理体制の確立

(単位：億円)	2012年3月期 (実績) (A)	2013年3月期 (期初計画) (B)	2013年3月期 (見込み) (C)	増減 (対計画比) (C-B)	増減 (対前期比) (C-A)
受注高	3,949	4,220	4,170	△50	+220
売上高	4,120	4,000	3,970	△30	△150
営業利益	232	270	225	△45	△7
経常利益	210	250	215	△35	+4
当期純利益	28	130	105	△25	+76

実績レート	1ドル=85.9円	—	—	—	—
想定レート	(上期)1ドル=80円 (下期)1ドル=75円	1ドル=75円	1ドル=75円	—	—

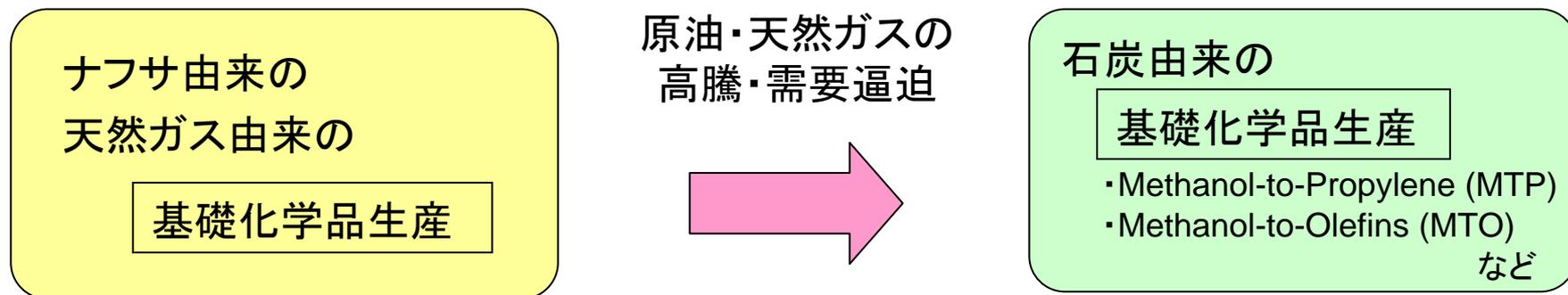
(1) 石油・ガス業界の市場環境推移と見通し

コンプレッサ・タービン事業(エリオット事業)の受注推移・見通し



:特に成長が見込まれる市場

(2) 中国 石炭化学分野を中心とした積極投資の動き

中国における炭化水素系化学製品生産の潮流の変化

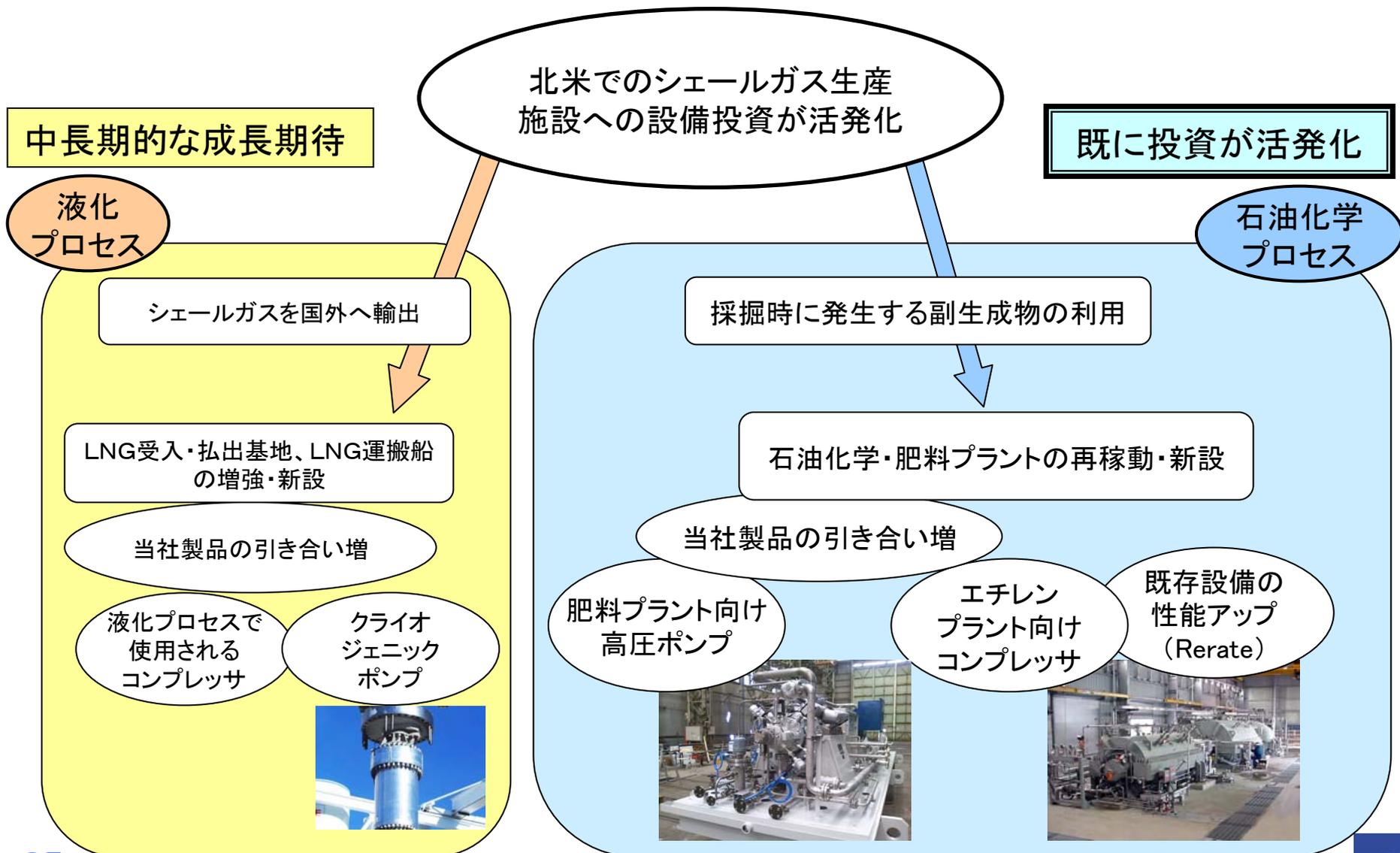
・中国政府の「十二・五（第12次5カ年計画、2011-2015年）」計画をうけて、2011年より石炭化学工業に対する投資が拡大。投資総額は7,000億元（8兆4,000億円）に達する見込み。

中国での主な今期受注済み案件

石炭化学関連プロジェクト	3件
PDH(プロパン脱水素)関連プロジェクト	3件
改造案件	2件

・今後の市場環境としても投資拡大が見込まれ、石炭化学案件を中心に引き続き隆盛と予測

(3) 本格化する北米シェールガス関連プロジェクト①



(4) 本格化する北米シェールガス関連プロジェクト②

世界のエチレン(モノマー)の生産能力 (単位:百万ト)

	世界計	うち アジア	うち 西欧	うち 北中南米	うち 中東
能力 2010	144.9	45.8	24.5	38.9	26.1
2016	173.2	62.8	24.2	45.1	29.1
増加幅 10-16	28.4	17.0	-0.3	6.2	3.0
伸び率 10-16	3.0%	5.4%	-0.2%	2.5%	1.8%

出典：経済産業省 製造産業局化学課「世界の石油化学製品の今後の需給動向」(平成24年6月)

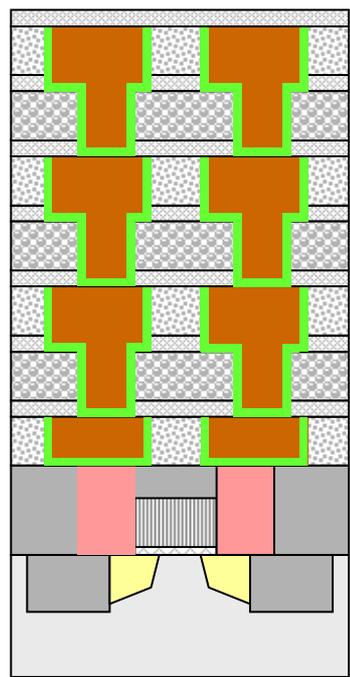
・北米エチレンプラントの新設・増設計画は2013年度以降本格化

2013年度発注が見込まれる案件	10件程度 (新設・増設・改造含めて)
新規案件 コンプレッサ発注規模	US\$ 50~60M/件
改造案件 コンプレッサ発注規模	US\$ 20~30M/件



(1) CMP技術のアプリケーションの広がり

半導体デバイス断面



↑
多層配線 8~12 x ダマシ

多層化と共に
CMP層数が増加

トランジスタ
1 x 絶縁膜
1 x コンタクト
1 x STI

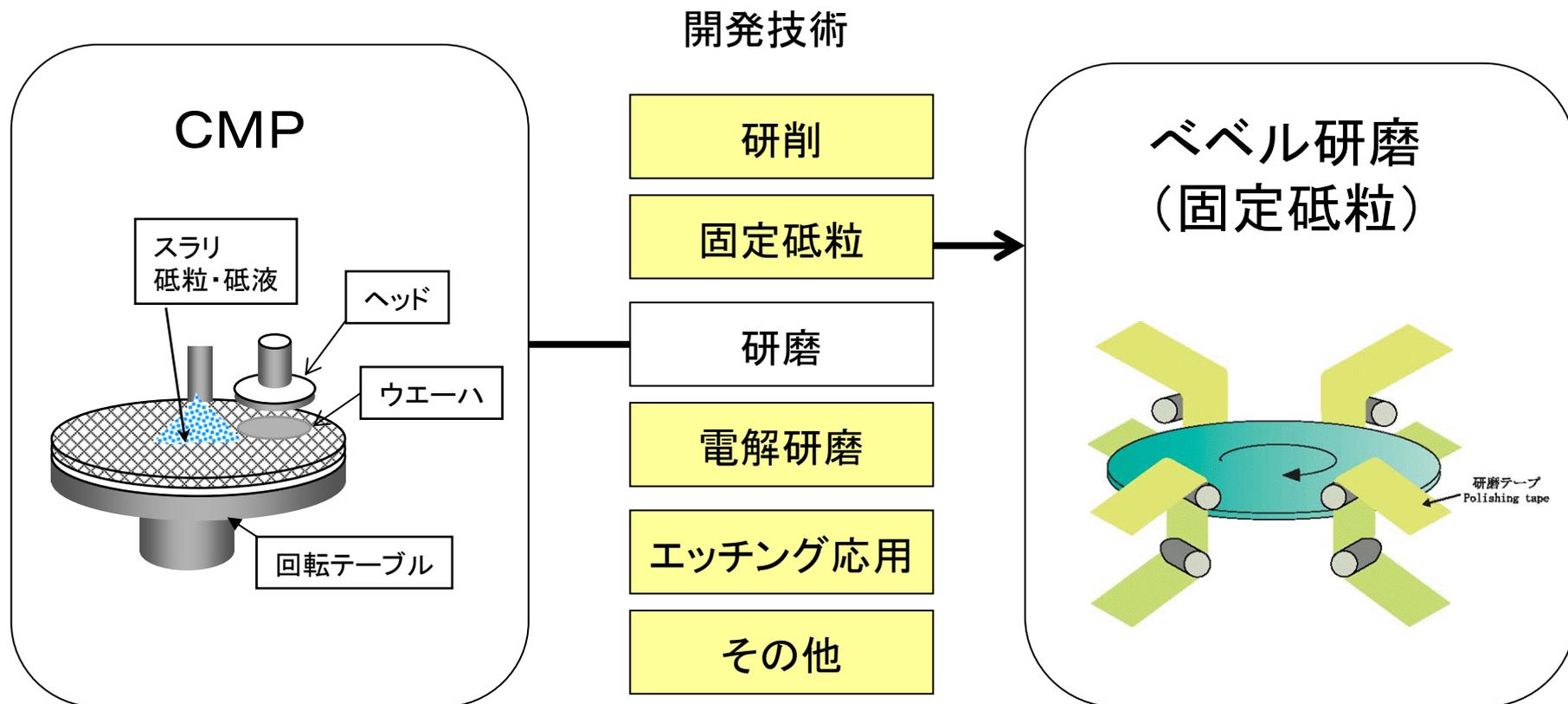
新規プロセス・新メモリ
でもCMP

3次元集積化 (TSV)
新揮発メモリ
3次元メモリ

微細化と共にCMP用途が増大

HKMGに
CMP採用 3Dトランジスタ
にもCMPを採用

(2) CMP技術から広げる新技術



$\frac{1}{10}$ の成功例も

$\frac{9}{10}$ の失敗例も財産

本資料に記載されている業績予想・計画ならびに将来予測は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定、を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。